

液晶ポリマー (LCP) をコア材とした
セミアディティブ法 (SAP) により
高密度、高精度の高周波 FPC の提供が可能です

用途提案

狭ピッチインピーダンスコントロール

配線ピッチ 50 μm 以下の狭ピッチで差動 100 Ω インピーダンスコントロールが可能で、信号反射を抑制しながら省スペース化に適しています。

狭ピッチ IC の実装

従来工法のサブトラクティブ法と比較して正確なパッド形状が可能で、狭ピッチ IC などを FPC に実装するパッド形成に適しています。

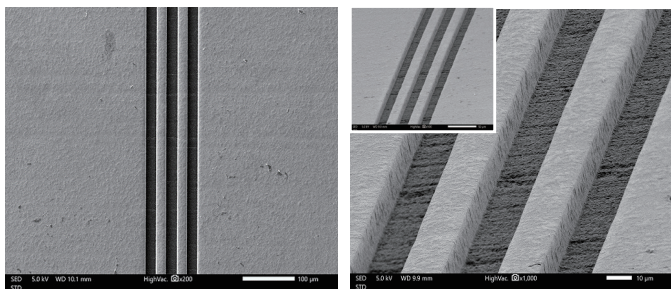
製品仕様例

- 層数 : 2 層
- 接続 Via : $\phi 0.1 \text{ mm}$ 貫通 Via
- ベース材料 : 液晶ポリマー(LCP) 50 μm 厚
- カバーコート : 低誘電力バレーイ、ソルダーレジストほか
- 導体厚み : 20 μm (参考値)
- ライン / スペース : 20/20 μm (参考値)
- インピーダンス整合 : 差動 100 $\Omega \pm 10\%$
- 表面処理 : 無電解 NiPdAu (ワイヤボンディング用途)

製品写真例

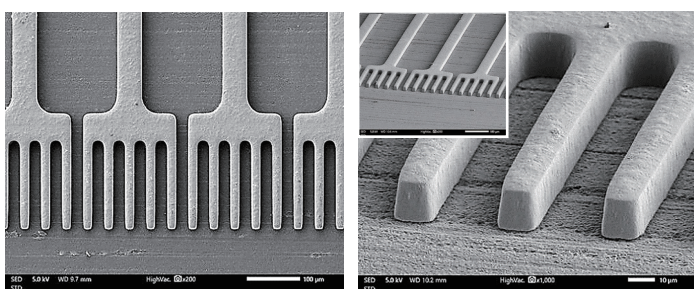
狭ピッチ差動 100 Ω 伝送路

L/S 20/20 μm



狭ピッチ部品の実装パッド

L/S 20/20 μm



材料提供 : 東洋鋼鈹株式会社様